

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：艾森股份
保荐代表人姓名：刘伟	联系电话：021-38966588
保荐代表人姓名：张帅	联系电话：021-38966588

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，对艾森股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024年4月，经保荐机构复核，因IPO审计费用口径计算错误，导致公司在2024年一季度使用募集资金支付IPO相关的审计验资费用时多支付2.83万元。公司已于2024年4月24日将多支付的资金由一般户返还至募集资金专户，及时完成整改。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、市场竞争风险

随着下游封测厂商持续加大投入先进封装技术，先进封装用电子化学品面临着良好的发展机遇。公司推出了多款先进封用光刻胶及配套试剂产品。先进封装领域具有较好的市场前景，其他内资厂商持续增加研发投入、扩建产能或推出新产品参与市场竞争。如公司未能持续更新技术及开发产品，降低产品成本，则公

公司将面临不断加大竞争压力，并降低公司光刻胶配套试剂的收入增速或市场份额。下游封测厂商对光刻胶的可靠性和稳定性要求极高，更换供应商难度较大。公司与国际巨头争夺高端市场，公司面临无法抢占其市场份额的竞争风险。综上，如果公司不能根据市场需求持续更新技术和开发产品，保持产品和技术竞争力，公司可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。

2、自研光刻胶产品产业化风险

公司自研光刻胶产品主要包括先进封装用负性光刻胶、OLED阵列制造正性光刻胶和晶圆制造i线正性光刻胶。公司主要自研光刻胶产品虽均已通过行业主要客户的认证并进入正式供货阶段，但尚未能实现对下游客户在用产品的完全替代，处于产业化前期，对收入贡献较低。由于下游客户对光刻胶的产品性能、品质及稳定性要求严格，相关产品认证时间及量产周期均较长，且影响因素众多，如受产品稳定性不足、客户推迟上线安排、下游市场需求变动等因素影响，公司自研光刻胶产品无法实现大规模产业化，将对公司未来发展带来不利影响。

(二) 经营风险

1、毛利率下降的风险

公司产品包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂以及电镀配套材料三大类别，不同类别产品的毛利率水平主要受所处行业情况、市场供求关系、产品技术特点、产品更新迭代、公司销售及市场策略、原材料价格等因素综合影响而有所差异。若原材料价格出现回升，或公司未能根据市场变化及时进行产品技术升级，产品技术缺乏先进性，公司市场推广未达预期，造成高毛利产品销售占比下降，可能导致公司毛利率水平下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、经营性现金流量为负的风险

公司经营性现金流量持续为负，主要系公司下游客户部分采取票据结算，而上游供应商接受票据结算的比例较低，为提高资金周转效率，公司将收到的部分票据进行贴现，票据贴现的资金流入计入“筹资活动产生的现金流量-取得借款收到的现金”所致。若公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，票据收款占

比提高，将会给公司营运管理带来一定压力。

3、原材料价格波动的风险

公司原材料主要包括各种溶剂类和固体类的化工原料，以及以锡材（锭）为主的金属材料；上述材料作为大宗工业原材料，其价格易受国际原油价格或国际金属价格的波动影响。

（三）行业风险

1、半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路、半导体显示等半导体产业。近年来，受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。如半导体行业下行周期持续，或公司不能通过开发新产品、开拓新客户等方式进行有效应对，将可能对公司经营业绩造成不利影响。

2、细分行业市场规模较小的风险

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。电子化学品具有品类多，应用领域细分等特点，公司主要产品为电镀液及配套试剂，主要应用于传统封装领域。公司的市场占有率较高，增长空间有限，存在细分行业市场规模较小的风险。虽然公司立足于传统封装领域电镀液及配套试剂，沿着产业链向其他应用领域发展，已逐步覆盖被动元件、PCB、先进封装、晶圆制造、光伏等领域的电镀工艺环节，若未来上述细分行业市场容量增长不及预期，将对公司经营情况和业绩情况产生不利影响。

三、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年，公司主要财务数据及指标如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2024年1-6月	2023年1-6月	增减幅度
营业收入	18,579.73	15,402.88	20.63%
归属于上市公司股东的净利润	1,373.95	1,111.86	23.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	819.63	1,090.85	-24.86%
经营活动产生的现金流量净额	-3,406.82	-5,274.21	不适用
主要财务数据	2024年6月30日	2023年12月31日	增减幅度
归属于上市公司股东的净资产	100,729.41	101,624.69	-0.88%
总资产	118,416.40	127,988.91	-7.48%
主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-47.06%
加权平均净资产收益率（%）	1.33	2.50	减少1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.79	2.45	减少1.66个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.33	8.83	增加2.5个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、报告期内，国内半导体行业总体呈复苏趋势，下游厂商需求回暖，公司实现营业收入18,579.73万元，同比增长20.63%。其中，电镀液及配套试剂销售收入同比增长13.31%，光刻胶及配套试剂销售收入同比增长44.57%；公司在先进封装领域的销售收入持续提高，营业收入表现出良好的增长趋势。

2、2024年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润为1,373.95万元，同比增长23.57%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为819.63万元，同比下降24.68%，主要原因系：（1）2024年1-6月，公司销售费用、管理费用和研发费用均有不同程度的增长，特别是研发费用同比增长54.81%，显

著高于营业收入增长速度；(2)公司于 2023 年 12 月首发上市募集资金到账，2024 年上半年公司资金利息收入和理财收益同比大幅增长；同时，2024 年上半年，公司取得政府补助 416.94 万元，同比增长 1,544.73%；资金收益及政府补助有效缓解了费用增长对净利润的不利影响。但因购买结构性存款取得的投资收益、公允价值变动损益以及取得的政府补助均计入非经常性损益，导致 2024 年上半年公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润变动方向相反。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,406.82万元，净流出较上年同期减少35.41%，主要系公司票据贴现减少，承兑到期现金流入增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术，公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案（Turnkey），满足客户对电子化学品的特定功能性要求。

在电镀液及配套试剂方面，公司在持续夯实传统封装国内龙头地位的基础上，逐步在先进封装以及晶圆28nm、14nm先进制程取得突破。在先进封装领域，公司先进封装用电镀锡银添加剂已通过长电科技的认证并取得小批量订单；先进封装用电镀铜基液（高纯硫酸铜）已在华天科技正式供应；先进封装用电镀铜添加剂处于批次稳定性验证阶段。在晶圆领域，公司28nm大马士革铜互连工艺镀铜添加剂产品已进入样品试制和产品认证阶段；14nm先进制程的超高纯硫酸钴已完成样品生产，在客户端测试进展顺利；晶圆制造铜制程用清洗液已完成客户测试认证，实现小批量交付。

在光刻胶及配套试剂方面，公司以光刻胶配套试剂为切入点，已成功实现附着力促进剂、显影液、去除剂、蚀刻液等产品在下游封装厂商的规模化供应。同时，公司积极开展光刻胶的研发，以先进封装负性光刻胶、OLED阵列制造用光刻胶以及晶圆用PSPI等特色工艺光刻胶为突破口，覆盖晶圆制造、先进封装及半

导体显示等应用领域，成功打破国外垄断，并逐步向先进制程延伸。目前，公司自研先进封装用负性光刻胶、晶圆制造i线正性光刻胶均已实现批量供应。

综上，2024年上半年公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

公司主要产品与下游行业结合紧密，需要企业具备丰富的实践经验和技术积累，研发技术门槛较高，具有研发投入大、研发周期长，下游客户认证时间长的特点。自成立以来，公司始终坚持以客户需求为导向，持续保持高研发投入，以保持技术领先和持续创新。2024年1-6月，公司研发费用2,105.16万元，同比增长54.81%，研发投入占营业收入比重11.33%，同比提高2.50个百分点。

2024年1-6月，公司各项在研项目均有序推进，部分项目取得阶段性成果。2024年1-6月，公司新增申请发明专利8项，实用新型专利3项，研发成果持续得到体现。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为28.03元/股。本次发行募集资金总额为人民币61,759.44万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为54,449.71万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15561号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集

资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	61,759.44
减：保荐及承销费用	4,627.89
募集资金实际到账金额	57,131.54
减：募集资金项目投入	10,012.39
支付发行费用	2,070.60
以闲置募集资金购买理财产品	30,100.00
以募集资金置换前期已支付发行费用	611.23
以募集资金置换前期投入募投项目金额	24,364.49
其中：年产 12,000 吨半导体专用材料项目	18,592.45
集成电路材料测试中心项目	5,772.04
募集资金专项账户手续费支出	0.09
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	13,000.00
募集资金理财产品利息收益	112.21
募集资金专项账户存款利息收入	169.08
募集资金专项账户余额	3,254.05

2024 年上半年，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金账户上年末余额	35,305.05
减：募集资金项目投入	8,693.60
发行费用	2,056.98
以闲置募集资金购买理财产品	9,600.00
以募集资金置换前期已支付发行费用	611.23
以募集资金置换前期投入募投项目金额	24,364.49
其中：年产 12,000 吨半导体专用材料项目	18,592.45
集成电路材料测试中心项目	5,772.04

项目	金额
募集资金专项账户手续费支出	0.07
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	13,000.00
募集资金理财产品利息收益	112.21
募集资金专项账户存款利息收入	163.15
募集资金专项账户余额	3,254.05

公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务/身份	直接持股数（万股）	间接持股数（万股）	合计持股数（万股）	合计持股比例（%）	2024 年上半年的质押、冻结及减持情况
1	张兵	董事长/实际控制人	1,903.1621	222.4387	2,125.6008	24.12%	无
2	蔡卡敦	实际控制人	684.7826	-	684.7826	7.77%	无
3	向文胜	董事、总经理	-	128.7747	128.7747	1.46%	无
4	陈小华	董事、常务副总经理、董事会秘书	53.3597	56.9170	110.2767	1.25%	无
5	杨一伍	董事	88.9328	58.6957	147.6285	1.68%	无
6	孙杨	董事	-	-	-	-	-
7	俞信华	董事	-	-	-	-	-

序号	姓名	职务/身份	直接持股数(万股)	间接持股数(万股)	合计持股数(万股)	合计持股比例(%)	2024年上半年的质押、冻结及减持情况
8	孙清清	独立董事	-	-	-	-	-
9	黄晓刚	独立董事	-	-	-	-	-
10	李挺	独立董事	-	-	-	-	-
11	程瑛	监事会主席	-	-	-	-	-
12	庄建华	监事	163.6364	-	163.6364	1.86%	无
13	熊秋丽	职工代表监事	-	-	-	-	-
14	赵建龙	副总经理	62.2530	17.7866	80.0396	0.91%	无
15	谢立洋	副总经理	-	46.2451	46.2451	0.52%	无
16	吕敏	财务总监	-	-	-	-	无

2024年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。


十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

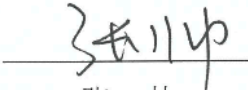
截至2024年6月30日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：


刘 伟


张 帅

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 8 月 27 日

